公司代码:688262 公司简称:国芯科技

苏州国芯科技股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度归属于母公司股东的净利润为-254,125,543.99元;截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为-363,816,340.19元。鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负,并结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况,公司拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不进行现金分红,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

公司第三届董事会第八次会议审议通过上述利润分配预案,该议案尚需提交股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-363,816,340.19元。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	国芯科技	688262	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚小刚	
联系地址	苏州市高新区经源路99号狮山总部经济中心1号楼	
电话	0512-68076528	
传真	0512-68096251	
电子信箱	IR@china-core.com	

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司,公司自成立以来一直采用Fabless的经营模式,专注于集成电路的设计、研发和销售,将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商、封装测试厂商完成。国产替代、新能源车行业等领域相关芯片定制服务,充分发挥原有定制芯片服务业务形成的大客户资源优势,持续推进公司业务可持续发展。公司致力于服务全球自主可控的国家战略,为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,主要产品应用于信创和信息安全、汽车电子和工业控制、人工智能和先进计算三大关键领域。

(1)IP授权,芯片定制服务业务

围绕自主可控CPU技术,基于“RISC-V指令集”“PowerPC指令集”和“M*Core指令集”,公司已成功研发了多个系列40余款嵌入式CPU内核,在国家重大需求和市场需求关键领域已实现较为广泛的应用,对客户开展IP授权业务。

凭借多年深耕细作所积累的深厚技术底蕴,公司可为客户提供定制芯片设计及定制芯片量产服务,抓住关键客户的主力芯片平台更新换代机会,特别是定制芯片量产服务的机会,在提升自身技术能力的同时,带来芯片定制化服务业务新的增长点,做出优势与特色。公司积极布局人工智能领域相关芯片定制服务,充分发挥原有定制芯片服务业务形成的大客户资源优势,紧密结合大客户发展AI芯片的业务需求,已为多个客户提供了AI芯片的定制设计和量产服务,成为整个公司营业收入的重要组成部分。

(2)自主芯片及模组产品业务

公司自主芯片及模组产品主要是围绕信创和信息安全、汽车电子和工业控制、人工智能和先进计算三大关键领域的芯片和模组,其中以汽车电子、信创和信息安全、AI MCU类为主,公司自主芯片产品的主要情况如下:

①汽车电子领域的主要产品

在汽车电子领域,公司重点发展汽车中高端MCU、DSP芯片和高集成数模混合信号芯片等方面的芯片产品和技术,开拓MCU+ASIC芯片套片组,形成具有技术优势和成本综合竞争力优势的套片解决方案,已在汽车域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用DSP芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等与汽车领域上实现系列化布局,不断拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度,在汽车域控制、动力总成、新能源电池管理、线控底盘、车身和网关控制、车联网信息安全、座舱音频和安全气囊点火芯片等领域均实现量产装车,为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出努力。具体包括:

产品类型	产品介绍	应用领域
域控制芯片	在域控制芯片领域,公司主要芯片产品包括CCP32016BC、CCP32017BC、CCP32007BC、CCP32007PT、CCP32010PT、CCP32011PT和CCP32012PT等产品,CCP32016BC、CCP32017BC芯片对标Infineon TC721和TC397,CCP32007BC芯片对标TC264和TC275,CCP32007PT系列对标NXP MPC5777,MPC5775和Infineon TC387系列。在已量产芯片CCP32007XX/CCP32008XX系列基础上,公司设计推出了更高性能的MCU CCP32010PT/CCP32011PT/CCP32012PT芯片系列,从而实现对域控制芯片性能的进一步全面覆盖。	智驾、动力、底盘和车身域控制等
辅助驾驶芯片	在汽车辅助驾驶芯片领域,公司的主要产品有CCP32012PT,可对标Infineon TC397/399系列芯片产品,公司自动力CCP32009PT芯片研发,设备端内生辅助驾驶和辅助融合领域应用而设计开发的新品种MCU芯片,片内基于220nm RHBD工艺,采用高性能CPU内核,集成了浮点运算和定点DSP运算单元,可以在主频≥400MHz(三个主核+6个锁步核),运行频率达到600MIPS,指计算力可达到3000DMIPS以上,约是CCP32012PT芯片的三倍,具备国际先进水平,该芯片在动力域控制上,在此基础上,公司正在开发CCP32XXX系列,对标Infineon的TC4DX系列,对标Infineon的TC3DX/TC4DX和Renesas的R7F701503/R7F701504等系列,对标Infineon的TC3EX和Renesas的R7U24A;CCP34008X系列,对标Infineon的TC40X和Renesas的R7U824。	辅助驾驶、智能座舱、多电机控制和网域融合
汽车电子专用DSP芯片	围绕新能源汽车主动降噪和汽车音响音效等开发需求,对标采用ADI公司车载应用主力产品线ADSP21469/ADSP21479/ADSP21489,公司推出了DSP芯片系列CCD6001/CCD3001/CCD3001,该系列芯片采用12nm先进工艺技术和生产。	汽车音频放大器、音响主机、主动降噪(ANC)和座舱域控制器等
动力总成芯片	公司推出了CCP32003PT、CCP32006PT、CCP32017BC、CCP32007PT、CCP32007BC等多款用于汽车动力总成的芯片,其中CCP32003PT对标NXP MPC5634,CCP32007PT对标NXP MPC5644,CCP32007BC芯片对标NXP MPC5744,CCP32017BC芯片对标Infineon TC277和Infineon TC377/387,NXP SPC5744B;高端动力总成控制芯片产品CCP32008PT芯片对标NXP MPC5775;高端动力总成控制芯片CCP32007PT对标NXP MPC5777,Infineon TC397,是公司基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。	内燃机、混合动力总成控制
新能源电池管理(BMS)芯片	在新能源电池控制芯片领域,公司推出的主要芯片产品有CCP32007PT、CCP32016BC、CCP32008PT、CCP32009PC等产品,CCP32007PT对标NXP MPC5744,CCP32008PT对标NXP MPC5775,Infineon TC264和TC275,CCP32009PC对标NXP MPC5775,Infineon TC264和TC275,对标Infineon的简化版本,对标Infineon TC234/TC334,可用于动力电池BMS的低成本方案。	启动电池、动力电池管理
线控底盘控制芯片	在底盘应用领域,公司推出的主要芯片产品系列有:CCP32012BC、CCP32011BC、CCP32016BC、CCP32017BC、CCP32008PC、CCP32009PC、CCP32010PP等产品,其中,其中CCP32012BC、CCP32011BC、CCP32016BC、CCP32017BC对标NXP MPC5604B/C、MPC5607B系列以及ST SPC56EB/SPC56EM系列,已经在客户的底盘产品实现批量应用,CCP32008PC、CCP32009PC、CCP32010PP对标英飞凌TC237系列,可用于轮胎制动系统和EPB电动助力转向系统的ECU,CCP32016BC、CCP32017BC对标英飞凌TC297x-box/TC397x-box等,可用于机械制动系统EMB、电动助力转向系统EPS、线控转向系统RWS以及集成式底盘域控制器等产品。同时,为方便客户底盘方案实现,公司还开发了多通道的传感器IMU芯片CCP32009PC和CCP32010PP,最高支持14路磁敏双轴/四轴IMU,六轴/九轴IMU,以及集成式底盘域控制器芯片CCP32020,构成线控底盘制动的IMU+ECU方案,以降低客户的方案BOM成本,基于电磁阀驱动芯片CCL2200B,公司已向多家客户推出CCP3007PT+CCL2200B和CCP3007+CCL2200B的IPB方案。	底盘集成制动系统(IBC)、线控制动系统(EHB)等;线控转向系统(RWS);电子机械制动系统(EMB)、电动助力转向系统(EPS)、线控转向系统(SBW)以及集成式底盘域控制器等
车身和网关控制芯片	在汽车车身和网关控制领域,公司于2014年推出了首颗车身和网关控制芯片CCP32002BC,该芯片对标NXP SPC560B,后续相继推出了中高端车身和网关控制芯片CCP32010BC/CCP32011BC/CCP32012BC等产品,对标NXP MPC5604B/C,MPC5607B系列以及ST的SPC56EB/L,SPC56EM/L系列,CCP32016BC/CCP32017BC,对标Infineon TC721和TC397,NXP SPC5744B系列,可实现对国外同类产品的替代,为现对汽车VCU、车身网关及车身域控集成在单芯片,公司推出了CCP32009PC/CCP32010PP等产品